

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Designed for Intel, AMD, Via, Freescale, NVidia and Texas Instrument processors that employ a BGA socket

Provides industry-leading conduction cooling performance, 10% improvement over current conduction cooling methods

Patent pending conduction cooling solution for small form factor electronics

Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape

Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad

Compatible with Interscale C enclosures

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Passt zu	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Breite
---------------	-----	----------	---------------------	-------	--------

24830-005	Wärmeleiter	Gehäuse	1	22 mm	22 mm
-----------	-------------	---------	---	-------	-------

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE